

AGENDA

Kupferoberflächen in der Leistungselektronik

Tag 1 //

- Dr. Helmut Schweigart
Leiter Reliability & Surfaces
Zestron Europe
- 13.00 // Begrüßung**
- Firmenpräsentationen gfkorr, ECPE, FED, Kupferverband e.V., ZESTRON Europe
 - Vorstellung des Tagesprogramms
 - Vorstellungsrunde und spezifischer Fokus der Teilnehmer

- Elke Frenznick
Development Specialist
Semikron Danfoss GmbH
- 13.30 // Anforderungen an Kupferoberflächen für die AVT in der Leistungselektronik**
- Material- und Oberflächeneigenschaften
 - Charakterisierung
 - Aufbautechnologien

14.30 // Pause

- Andreas Bührle
Application Engineering
Wieland-Werke AG
- 14.45 // Kupferhalbzeuge für Leadframes und Leistungsmodule**
- Standardlösungen
 - Übliche Oberflächenspezifikationen
 - Kundenwünsche, Grenzen und Erfahrungen

- Dr. Steffen Link
Forschung und Entwicklung
Zestron Europe
- 15.45 // Bestimmung von Oxidationszuständen mittels Sera-Verfahren**
- Anforderungen an die Substratoberfläche
 - Einflüsse auf den Kurvenverlauf
 - Anwendungsbeispiele und Grenzen des Verfahrens

16.45 // Diskussions- und Fragerunde

17.00 // Ende des ersten Tages

18.00 // Abendprogramm

AGENDA

Kupferoberflächen in der Leistungselektronik

Tag 2 //

Dr. Helmut Schweigart **09.00 // Oberflächen und ihr Einfluss auf Feuchterobustheit**

- Adhäsionsstörungen und ECM
- Adhäsionsstörungen und Kriechkorrosion
- Kohäsionsstörungen und AMP

Kristyna Zakova **09.30 // Nasschemische Konditionierung vs. Plasma-Reinigung**

- Applied Research
Zestron Europe
- Anforderungen an Oberflächen für Molding, Potting und Underfill
 - Spezifische Vor- und Nachteile beider Verfahren

10.00 // Pause

Prof. Dr.-Ing. Guido Grundmeier **10.30 // Molekulare und makromolekulare Funktionalisierung von Kupfer und Aluminium-Kupfer-Legierungen**

- Technical and Macromolecular Chemistry
Universität Paderborn
- Adsorption und Graftingprozesse
 - Grenzflächenchemie und Korrosionsanalytik
 - Einfluss von Oxidschichten und Mikrostruktur

Dr. Helmut Schweigart **11.30 // Abschlussdiskussion**

- Offene Fragen und Zusammenfassung
- Problemstellungen der Teilnehmer

11.45 // Mittagspause

12:45 // Ende der Veranstaltung
